


Dell™ Studio XPS™ 8000 – Szczegółowe dane techniczne

W tym dokumencie przedstawiono informacje, które mogą być przydatne podczas konfigurowania lub modernizowania komputera oraz aktualizowania sterowników.

UWAGA: Oferowane opcje mogą być różne w różnych krajach. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji zakupionego komputera, kliknij **Start**  **Pomoc i obsługa techniczna** i wybierz opcję przeglądania informacji o komputerze.

Procesor	Złącza na płycie systemowej
Napędy i urządzenia	Złącza zewnętrzne
Pamięć	Gniazda rozszerzeń
Informacje o komputerze	Zasilanie
Magistrala rozszerzeń	Bateria
Grafika	Wymiary i masa
Dźwięk	Środowisko pracy komputera
Czytnik kart pamięci	

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2009 Dell Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie tych materiałów w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody firmy Dell Inc. jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: *Dell*, logo *DELL* i *Studio XPS* są znakami towarowymi firmy Dell Inc.; *Intel* jest zastrzeżonym znakiem towarowym, a *Core* jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach; *Blu-ray Disc* jest znakiem towarowym firmy Blu-ray Disc Association; *Bluetooth* jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc., używanym przez firmę Dell na podstawie licencji.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Inc. nie rości sobie praw własności do znaków towarowych i nazw towarowych innych niż jej własne.

Model: D03M series

Typ: D03M001

Sierpień 2009

Wersja A00

Procesor

Typ	Intel® Core™ i7-870 Intel Core i7-860 Intel Core i5-750
Pamięć podręczna L1	32 KB
Pamięć podręczna L2	256 KB
Pamięć podręczna L3	8 MB

[Powrót do początku](#)

Napędy i urządzenia

Dostępne z zewnątrz	<ul style="list-style-type: none"> dwie wnęki 5,25 cala na napęd hybrydowy SATA
---------------------	--

	DVD+/-RW Super Multi Drive lub Blu-ray Disc™ albo napęd dysków Blu-ray Disc RW <ul style="list-style-type: none"> • jedna wnęka 3,5 cala na moduł Flexdock lub Bluetooth®
Sieć bezprzewodowa (opcjonalna)	interfejs bezprzewodowy WiFi/Bluetooth®
Dostępne od wewnątrz	dwie wnęki 3,5 cala na dyski twarde SATA

[Powrót do początku](#)

Pamięć

Złącza	cztery gniazda DDR3 DIMM dostępne od wewnątrz
Pojemność	1 GB, 2 GB i 4 GB
Typ pamięci	DDR3 DIMM 1066 MHz lub 1333 MHz; (tylko pamięć bez korekcji błędów ECC)
Obsługiwane konfiguracje pamięci	4 GB, 6 GB, 8 GB, 12 GB i 16 GB (64-bitowa wersja systemu operacyjnego)

[Powrót do początku](#)

Informacje o komputerze

Systemowy zestaw układów	Intel P55
Przepustowość magistrali danych	2,5 GT/s
Przepustowość magistrali DRAM	64 bity
Przepustowość szyny adresowej procesora	64 bity
Obsługa systemu RAID (tylko wewnętrzne dyski SATA)	RAID 0 (przeplot) RAID 1 (zapis lustrzany)
Układ scalony BIOS (NVRAM)	8 MB
Szybkość pamięci	1333 Mhz

[Powrót do początku](#)

Magistrala rozszerzeń

PCI Express	<ul style="list-style-type: none"> • dwukierunkowe złącze Gen2 x1 o szybkości 500 MB/s • dwukierunkowe złącze Gen2 x16 o szybkości 16 GB/s
PCI:	32-bit złącze o częstotliwości taktowania 33 MHz
SATA 2.0	1,5 Gb/s i 3,0 Gb/s
USB 2.0	<ul style="list-style-type: none"> • tryb dużej szybkości — 480 Mb/s • tryb pełnej szybkości — 12 Mb/s • tryb niskiej szybkości — 1,2 Mb/s

[Powrót do początku](#)

Grafika

Autonomiczna	karta PCI Express x16
--------------	-----------------------

[Powrót do początku](#)

Dźwięk

Typ	zintegrowana karta dźwiękowa z obsługą dźwięku dookólnego 7.1 wysokiej jakości z obsługą S/PDIF
-----	---

[Powrót do początku](#)

Czytnik kart pamięci

Obsługiwane karty	<ul style="list-style-type: none"> • CompactFlash (CF) • Smart Media (SM) • xD-Picture (xD) • Memory Stick (MS) • Memory Stick PRO (MSPRO) • Memory Stick PRO HG (MSPRO HG) • SecureDigital (SD) • SecureDigital Card (SDHC) 2.0 • MultiMedia Card (MMC) • MicroDrive (MD)
-------------------	--

[Powrót do początku](#)

Złącza na płycie systemowej

Pamięć	cztery złącza 240-stykowe
--------	---------------------------

PCI:	jedno złącze 124-stykowe
PCI Express x1	Dwa złącza 36-stykowe
PCI Express x16	jedno złącze 164-stykowe
Zasilanie (płyta systemowa)	jedno złącze 24-stykowe 12 V (zgodne ze standardem ATX)
Wentylator procesora	jedno złącze 4-stykowe
Wentylator obudowy	jedno złącze 3-stykowe
Przednie złącze USB	pięć złączy 9-stykowych
Przednie złącze audio	jedno złącze 9-stykowe dwukanałowego dźwięku stereo i mikrofonu
SATA	cztery złącza 7-stykowe
Wyjście S/PDIF	złącze 5-stykowe

[Powrót do początku](#)

Złącza zewnętrzne

Karta sieciowa	złącze RJ45
USB	złącza zgodne z USB 2.0 (dwa na panelu górnym, dwa na panelu przednim i cztery na panelu tylnym)
Dźwięk	<ul style="list-style-type: none"> panel górny - złącza słuchawek i mikrofonu panel tylny - sześć złączy do obsługi dźwięku dookólnego 7.1
S/PDIF	jedno złącze S/PDIF (optyczne)
eSATA	jedno złącze na panelu tylnym
IEEE 1394a	jedno 6-stykowe złącze szeregowe na panelu tylnym

[Powrót do początku](#)

Gniazda rozszerzeń

PCI :	
Złącza	jedno
Rozmiar złącza	złącze 124-stykowe
Przepustowość danych złącza (maksymalna)	32 bity
PCI Express x1	
Złącza	dwa
Rozmiar złącza	złącze 36-stykowe
Przepustowość danych złącza (maksymalna)	1 tor PCI Express

PCI Express x16	
Złącza	jedno
Rozmiar złącza	złącze 164-stykowe
Przepustowość danych złącza (maksymalna)	16 torów PCI Express

[Powrót do początku](#)

Zasilanie

Zasilacz prądu stałego	
Moc	350 W
Maksymalna emisja ciepła	1836 BTU/godz.
UWAGA: Emisja ciepła jest obliczana na podstawie specyfikacji mocy zasilania.	
Napięcie wejściowe	prąd przemienny 115–230 V
Częstotliwość wejściowa	50/60 Hz
Nominalny prąd wyjściowy	8 A/4 A
Bateria pastylkowa	litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032

[Powrót do początku](#)

Bateria

Bateria pastylkowa	litowa bateria pastylkowa 3 V CR2032
--------------------	--------------------------------------

[Powrót do początku](#)

Wymiary i masa

Wysokość	407,75 mm (16,02 cala)
Szerokość	185,81 mm (7,31 cala)
Głębokość	454,67 mm (17,90 cala)
Masa	10,18 kg (22,40 funta)

[Powrót do początku](#)

Środowisko pracy komputera

Zakres temperatur:	
--------------------	--

Podczas pracy	10° C do 35° C (50° F do 95° F)
Podczas przechowywania	-40° C do 65° C (-40° F do 149° F)
Wilgotność względna	20% do 80% (bez kondensacji)
Maksymalne drgania (z zastosowaniem spektrum losowych wibracji, które symulują środowisko użytkownika):	
Podczas pracy	0,25 GRMS
Podczas przechowywania	2,2 GRMS
Maksymalny wstrząs (mierzony dla dysku twardego z zaparkowanymi głowicami i impulsu półsinusoidalnego o długości 2 ms):	
Podczas pracy	Impuls półsinusoidalny: 40 G przez 2 ms przy przyspieszeniu 20 cali/s (51 cm/s)
Podczas przechowywania	Impuls półsinusoidalny: 50 G przez 26 ms przy przyspieszeniu 320 cali/s (813 cm/s)
Wysokość nad poziomem morza (maksymalna):	
Podczas pracy	-15,2 do 3048 m (-50 do 10 000 stóp)
Podczas przechowywania	-15,2 do 10 668 m (-50 do 35 000 stóp)
Poziom zanieczyszczeń w powietrzu	G2 lub niższy wg standardu ISA-S71.04-1985

[Powrót do początku](#)